

NSPACK, YSPACK, HSPACK, YSSOCKET をご使用の前に

1. 本製品は、システムでの開発、評価での使用を想定したものです。また、国内の使用に際し、電気用品安全法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。開発および評価用のソケットとしてご使用下さい。尚、NSPACK、YSPACK、HSPACK、YSSOCKET は RoHS 対応製品です。
2. NSPACK/IC/HSPACK および NSPACK/YSPACK のシステムは、振動および衝撃環境にはご使用になれません。
3. ご使用する IC は、NSPACK の適合可能な IC 寸法表上でご確認下さい。(同寸法表は、カタログを参照して下さい。)NSPACK/YSPACK/HSPACK をケースから取り出す時、本体を押さえてからスポンジを先に取り出して下さい。
4. ケースを 50 以上の場所に長時間放置すると、変形する場合がありますので、保管については 40 以下の直射日光の当たらない場所に置いて下さい。
5. IC を NSPACK に搭載する場合、IC4 隅の樹脂部(封止剤部)のバリがないことを確認して下さい。バリがある場合、ナイフ等で除去して下さい。
6. IC のリードは強度が弱いので、NSPACK へ数回脱着することによりリードが曲がることが多いので、IC を NSPACK へ装着する時、リードの曲がりを点検・補正して下さい。
7. NSPACK に YSPACK/HSPACK をネジ止めする時、添付の専用ドライバー、またはトルクドライバーで 2ヶ所のネジを仮止め後、順次ネジを締めて下さい。締め付けトルクの推奨値は $0.054\text{N}\cdot\text{m}$ ($0.55\text{kgf}\cdot\text{cm}$) です。1ヶ所のみを強く締めると、接続不良の原因となることがあります。
8. YSPACK、YSSOCKET の挿抜において、こじったり、揺らしたりすると YSPACK のピン曲がりが発生する恐れがありますので、(-)ドライバーで4方から少しずつ抜去して下さい。
9. YSPACK と接続する基板には、所定の位置に部品穴(2ヶ所: 2.3mm)が必要です。ネジの頭の大きさ 3.8mm は配線禁止区域となります。
10. NSPACK をハンダ付けする際、フラックス飛散防止のため、HSPACK をカバーとして被せて下さい。推奨ハンダ付け条件 リフロー: 260 × 10 秒以内、手ハンダ: 350 × 5 秒以内(1ピン)です。熱風式ハンダ装置のご使用もお奨めします。また鉛フリー対応です。
11. NSPACK、YSPACK、YSSOCKET は、構造上洗浄液がソケット内に残る恐れがあるため、洗浄は行わないで下さい。
12. NSPACK/IC/YSPACK の組合せでは、ご使用になれません。
13. NSPACK/IC/HSPACK の組合せは、評価用のソケットとしてご使用下さい。
14. NSPACK/IC/HSPACK の使用中に温度が上がり、IC の動作が不安定になる場合があります。その場合、扇風機等でソケット全体を冷却して下さい。

